

令和3年 7月26日

NEDIA会員各位

(一社)日本電子デバイス産業協会
事務局次長 小林関司

材料部品部会主催・第三十二回勉強会開催のご案内

盛夏の候、皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。

下記の日程で「第三十二回材料部品部会主催の勉強会」を開催いたします。

今回の勉強会では、半導体産業の動向と最新電子機器の解析による実装技術の動向についての講演をしていただく予定です。

今回、特別講師といたしまして昨年に続きまして、TV雑誌等で大活躍をされております真田家(松代藩)14代目の真田幸光先生をお招きして混乱している世界情勢の分析と今後の日本の対応についてのお話をさせていただきます。

新型コロナウイルス感染防止に努めながらの開催になりますが、是非大勢の方のご参加をお待ちしております。

—記—

1. 日時 令和 3年 9月 9日(木) (14:00~16:40)
2. 場所 御茶ノ水めつきセンター4F会議室
東京都文京区湯島1-11-10
03-3814-5621(代)

3. 講演スケジュール

(1) (14:00~14:50)

テーマ「電子デバイス産業のカギとなる最先端パッケージング・実装技術!!」
講師 加藤 凡典 氏 / (有)AIT代表取締役

休憩時間 (14:50-15:00)

(2) (15:00~16:40)

テーマ「混沌がさらに深まる世界、日本を読む!!」
講師 真田 幸光 氏 / 愛知淑徳大学ビジネス学部 教授

(注) 添付の用紙に出欠を記入の上、9月3日までにメールにて事務局宛に返信をお願い致します。定員(40名)になり次第締め切らせていただきます。 以上